

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2021-116

证券代码：123115

证券简称：捷捷微电

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于全资子公司获得发明专利的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、获得发明专利的情况

江苏捷捷微电子股份有限公司全资子公司捷捷半导体有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下：

##### 第一项发明专利介绍：

发明名称：一种电极片与半导体器件

专利号：ZL 2021 1 0957827.1

专利类型：发明专利

申请日期：2021 年 08 月 20 日

授权日：2021 年 11 月 02 日

本发明提供了一种电极片与半导体器件，涉及半导体技术领域。该电极片包括多个散热元与连筋，散热元呈阵列排布，且相邻两个散热元通过一条连筋连接，其中，散热元的形状为多边形，连筋与散热元之间成锐角设置。本发明的电极片与半导体器件具有不易出现芯片损坏的优点。

##### 第二项发明专利介绍：

发明名称：一种芯片封装结构及其制作方法

专利号：ZL 2021 1 0971948.1

专利类型：发明专利

申请日期：2021 年 08 月 24 日

授权日：2021 年 11 月 02 日

本发明提供了一种芯片封装结构及其制作方法，涉及芯片塑封技术领域。该芯片封装结构包括塑封体、至少两个半导体芯片、至少一个中间电极片、第一外侧电极片以及第二外侧电极片，相邻两个半导体芯片之间至少包括一个中间电极片，第一外侧电极片与第二外侧电极片分别位于至少两个半导体芯片的最外侧，塑封体套设于至少两个半导体芯片、至少一个中间电极片、第一外侧电极片以及第二外侧电极片外；其中，中间电极片的第一散热面穿过塑封体并裸露于塑封体的外侧。本发明提供了一种芯片封装结构及其制作方法具有体积小，散热能力强的优点。

上述发明专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，巩固和保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日